

聚辰半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

活动类别	☒特定对象调研 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☐其他 ☐媒体采访 ☐路演活动
------	---

	长信基金	睿远基金	长盛基金	中海基金
	万家基金	君成基金	巨杉资产	富安达基金
	潼骁投资	开源证券	途灵资产	红塔红土基金
	宝盈基金	九泰基金	麦格理资本	圆信永丰基金
	山楂树甄琢资产	德邦基金	合远基金	煜德投资
	天弘基金	渊泓投资	创金合信基金	招商基金
	晨燕资产	中才中环投资	弘开投资	猎投资本
	易米基金	中颖投资	青榕资产	宏道投资
	国华兴益保险	睿胜基金	港丽投资	中银基金
	九泰基金	麦格理资本		
活动时间	2026 年 8 月 17 日			
活动地点	网络会议			
接待人员	职 务		姓 名	
	董事、董事会秘书		翁华强	
	存储事业部总经理		邵 丹	
	投资者关系总监、董事会办公室副主任		孙 远	
活 动 主 要 内 容	一、公司近期经营情况介绍 公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2026 年上半年的经营情况。 二、投资者交流环节 1、二季度扣非净利润大幅增长的原因 进入第二季度以来，随着部分下游应用市场需求的回暖，SOCAMM2 与 LPCAMM2 等新型 DDR5 内存模组的陆续商用，以及公司不断加强对			

产品的推广、销售及综合服务力度，公司 DDR5 SPD 芯片、应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性 EEPROM 芯片的出货量较第一季度实现快速增长，带动公司综合毛利率较第一季度增加约 4.79 个百分点，第二季度扣非净利润环比增长 147.20%，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力。

2、研发投入情况

公司持续扩大研发投入，不断完善技术储备和产品布局，上半年研发投入 1.29 亿元，同比增长 25.71%，占营业收入的比例为 21.44%，较去年同期增加 3.58 个百分点，均创历史新高。

3、VPD 芯片进展

公司与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商合作，率先推出配套新一代 EDSFF eSSD 模组的 VPD 芯片，目前已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证。

4、新一代 EDSFF eSSD 模组优势

随着企业级固态硬盘（eSSD）模组部署密度的快速提升，传统 U.2 eSSD 模组和 M.2 eSSD 模组的电气性能（特别是信号完整性）、存储密度、运维效率和散热系统愈发难以满足需求复杂的现代企业级存储市场，而新一代 EDSFF eSSD 模组专为应对该等挑战设计，有望在未来取代 U.2 eSSD 模组和 M.2 eSSD 模组，以满足企业及数据中心在计算、存储和 AI 应用等方面的需求。

5、汽车电子存储芯片情况

上半年，公司积极进行欧洲、美国、韩国、日本、东盟等海外重点市场的拓展，汽车级 EEPROM 芯片成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，广泛应用于全球前 20 大中的 16 大、以及国内前 20 大的全部汽车品牌的核心元器件，产品的销量和收入占公司整体业务的比重快速提升。汽车级 NOR Flash 芯片向应用端进行延伸，成功搭载在国内外多款主

	流品牌汽车的视觉感知和智能座舱系统中导入市场，上半年销量和收入较上年同期实现高速增长，进一步丰富了公司在汽车级存储芯片领域的产品布局。 6、工业控制市场应用领域 公司在工业应用市场具有较深厚的积累，高性能工业级 EEPROM 芯片现已广泛应用于工业自动化（如伺服控制、机器人、人机交互）、数字能源（如光储充一体、逆变器）以及通信基站/服务器（如高速光模块）等领域，市场份额快速提升，与众多全球领先的设备厂商形成了长期稳定的合作关系。
附件清单	无